

# Systemy klejenia okładzin ceramicznych i kamiennych

Przewodnik



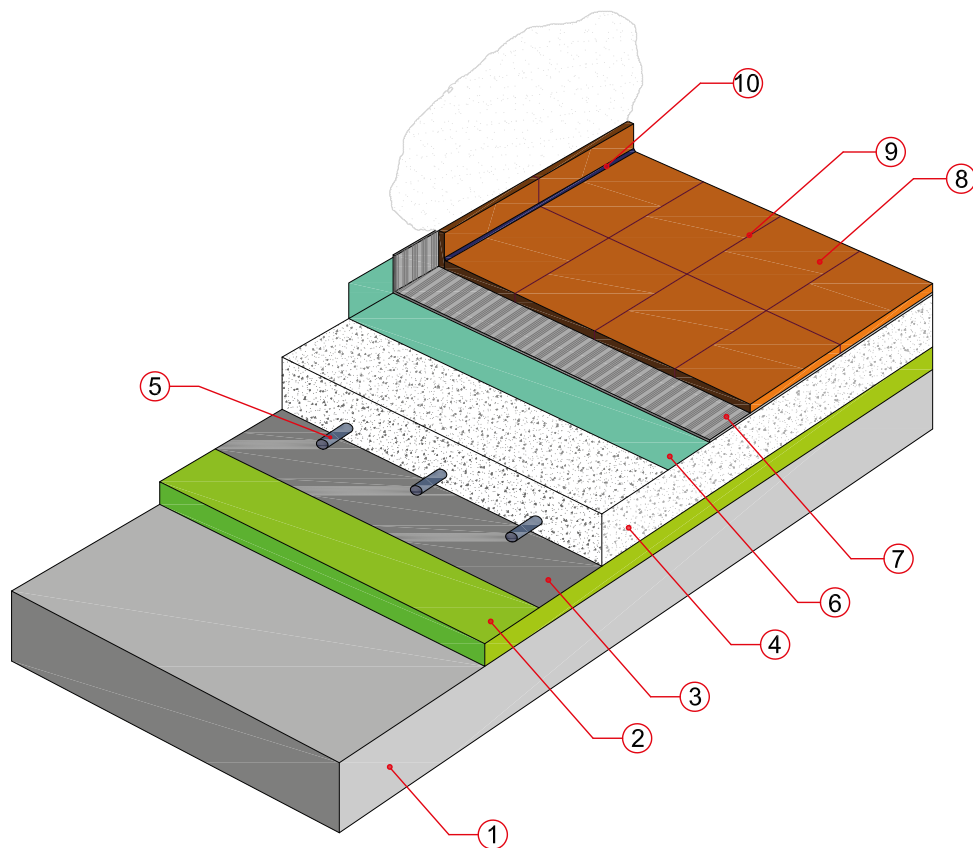
A brand of

**BASF**

We create chemistry

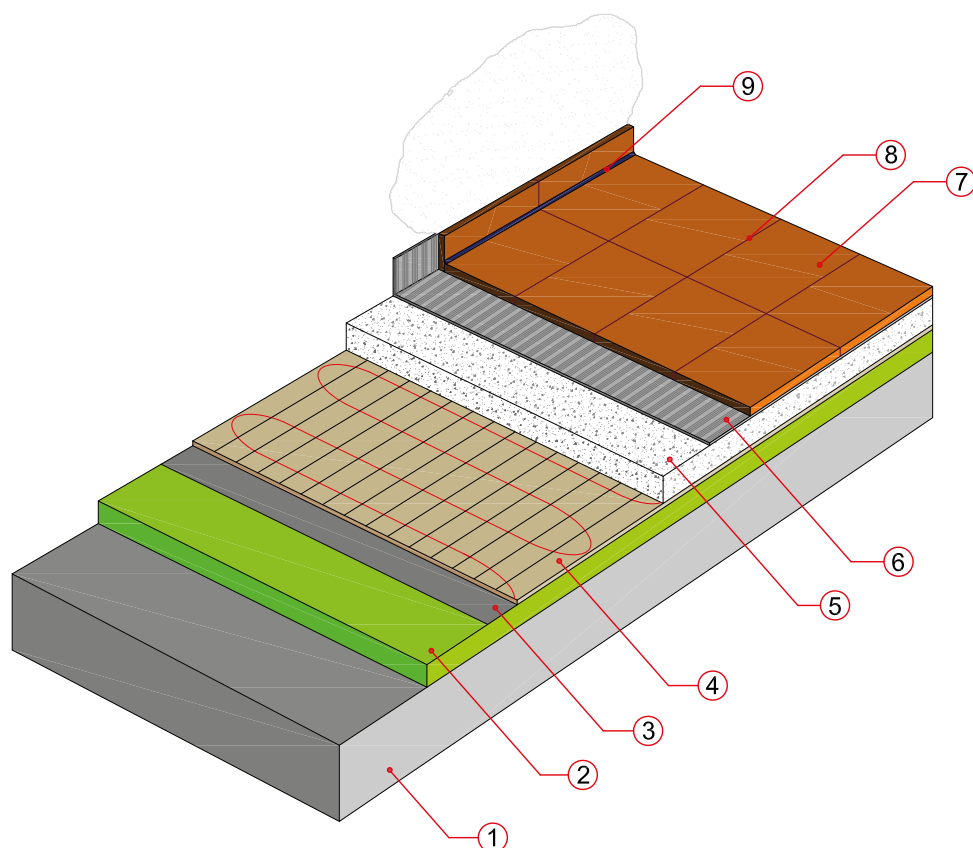
## 6. Płytki na ogrzewaniu podłogowym

Wariant 1 - ogrzewanie wodne



Nr	Elementy systemu	Produkt PCI	Opis produktu
1	Strop betonowy		
2	Termoizolacja		
3	Folia PE		
4	Jastyrych		
5	Rury grzewcze		
6	Grunt	PCI Gisogrund	Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
7	Klej do płytek	PCI Pericol Flex	Elastyczny klej cementowy w metodzie kombinowanej
8	Płytki		
9	Fuga	PCI Nanofug Premium	Elastyczna fuga cementowa
10	Uszczelniacz	PCI Silcofug E	1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

## Wariant 2 - ogrzewanie elektryczne



Nr	Elementy systemu	Produkt PCI	Opis produktu
1	Strop betonowy		
2	Termoizolacja		
3	Folia PE		
4	Mata grzewcza		
5	Wylewka cementowa	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	Cementowa masa poziomująca z rozproszonym włóknom
6	Klej do płytek	PCI Pericol Flex	Elastyczny klej cementowy w metodzie kombinowanej
7	Płytki		
8	Fuga	PCI Nanofug Premium	Elastyczna fuga cementowa
9	Uszczelniacz	PCI Silcofug E	1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

## Opis obiektu - warunki eksploatacji - obciążenia

Okładziny płytkowe na ogrzewaniach podłogowych występują powszechnie w budownictwie mieszkaniowym, biurowym i użyteczności publicznej (hotele, restauracje itp.). Do typowych dla danego rodzaju budownictwa obciążeń mechanicznych, wywołanych ruchem osób i naciskiem umeblovania, dochodzą tu obciążenia termiczne, spowodowane zmianami temperatury posadzki. Wynikają one ze zmian temperatury warstw posadzki w okresie włączania lub wyłączania ogrzewania, a także w sytuacjach gdy ogrzewanie pracuje tylko w niektórych strefach posadzki. Ogrzewania elektryczne wywołują większe naprężenia niż wodne, gdyż po ich uruchomieniu następuje szybsze rozgrzanie posadzki i parowanie zawartej w niej wilgoci. Projekt posadzki z ogrzewaniem winien opisywać rozmieszczenie pól grzewczych, dylatacji między nimi, format i rozmieszczenie poszczególnych płytek oraz szerokość fug. Przedstawione niżej zalecenia odnoszą się do przykładowych rozwiązań, prezentowanych na schematach powyżej.

## Podłoże

Podłożem okładziny jest zazwyczaj jastrych cementowy lub anhydrytowy albo wylewka poziomująca, w których wbudowano elementy grzejne. Oprócz typowych dla każdej posadzki płytkowej wymagań co do czystości i nośności, podłoża te winny legitymować się dojrzałością, potwierdzoną próbnym wygrzewaniem. Jeżeli wymagane jest szybkie wykonanie robót, do wbudowania elementów grzewczych można użyć wylewki cementowej z rozproszonym zbrojeniem włóknami polimerowymi **PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34**. Jeżeli przed układaniem okładziny płytkowej nie wykonano próbnego wygrzewania jastrychu lub planuje się rozmieszczenie płytek w sposób nie uwzględniający rozgraniczenia pól grzewczych, można to zrealizować przy użyciu arkusza oddylatowującego **PCI Pecilastic U**, który zostanie naklejony na jastrychu grzewczym jako podłoże pod przyklejenie okładziny. Co do szczegółów takiego rozwiązania należy skontaktować się z Regionalnym Doradcą Technicznym PCI.

## Wykonawstwo

### A. GRUNTOWANIE

O ile podłożem nie jest masa jastrychowa lub wylewka poziomująca PCI, zaleca się przegruntowanie dyspersyjnym gruntem **PCI Gisogrund**, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 do 1:2.

### B. WYKLEJENIE PŁYTEK

Do mocowania okładziny płytkowej zaleca się użycie elastycznego kleju cementowego **PCI Pericol Flex** w metodzie kombinowanej.

### C. SPOINOWANIE PŁYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: **PCI Nanofug Premium**.

W dylatacjach wewnątrz posadzki i dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym **PCI Silcofug E**.

## Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.